

December 26, 2024

미국의 대중 반도체 수출통제 확대 조치의 주요 내용 및 시사점

법무법인(유한) 태평양의 『통상 Legal Update』는 국제통상질서가 급변하고 있는 상황에서 미-중 패권경쟁, EU 신통상규범, 공급망 재편, 디지털 전환, 탄소중립 등 다양한 통상이슈의 전개 동향을 발 빠르게 파악하고 미국, EU, 중국 등 주요국의 통상관련 법률과 정책을 면밀히 분석하여 이에 관한 최신 정보를 정부, 기업, 관계기관에 제공합니다.

I. 배경

미국 상무부 산업보안국(이하 "상무부")은 2024. 12. 2. 대중 수출통제 조치를 강화하는 내용을 담은 수출관리규정(Export Administrations Regulations, 이하 "EAR") 개정안을 발표했습니다. 이번 개정은 중국이 군사력 현대화를 목적으로 인공지능 개발에 사용하는 첨단 반도체 생산 체계의 발전을 견제하기 위한 일환으로 추진되었습니다. 금번 조치에 따라 (1) 반도체 칩 및 장비의 수출통제 범위가 확대되고¹, (2) 우려거래자 목록(Entity List) 등재 대상이 추가되는² 등 전반적으로 중국에 대한 수출통제가 강화되었습니다. 특히, 외국산 반도체 제조 장비가 미국산 품목과 동등한 수준의 수출통제를 받도록 하기 위해 해외직접생산품 규칙(이하 "FDPR")³과 최소허용기준(*de minimis*)⁴ 관련 조항들이 신설되고 강화된 점이 주목됩니다. 동 조치는 2025. 1. 1.부터 시행될 예정입니다(단, 우려거래자 목록의 등재 대상 추가 조치는 즉시 발효되었습니다).

본 뉴스레터에서는 상무부에서 발표한 EAR 개정안의 내용을 간략히 살펴보고, 동 지침과 관련하여 우리 기업이 고려할 수 있는 시사점에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

-
- ¹ 'Foreign-Produced Direct Product Rule Additions, and Refinements to Controls for Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items' (법안 원문: <https://public-inspection.federalregister.gov/2024-28270.pdf>)
 - ² Additions and Modifications to the Entity List; Removals from the Validated End-User (VEU) Program (법안 원문: <https://public-inspection.federalregister.gov/2024-28267.pdf>)
 - ³ 외국산 품목이 △특정 유형의 미국산 소프트웨어 또는 기술을 활용한 직접생산품에 해당하거나 직접생산품인 공장 또는 공장의 주요 장비에서 생산된 제품 등이며, △특정 국가가 목적지인 경우, EAR상 해외직접생산품규칙(FDPR)이 적용되어 EAR 적용 대상이 됩니다.
 - ⁴ 외국산 품목이 특정 가액기준에서 일정 비율(최소허용기준, *de minimis* rule)을 초과한 EAR 통제대상 미국산 품목을 포함하는 경우, 해당 품목은 EAR 적용 대상이 됩니다. 최소허용기준은 품목 및 목적지에 따라 0%, 10%, 25% 등으로 구분됩니다.

II. 대중 수출통제 조치의 주요 내용

1. 반도체 칩 통제 범위 확대

상무부는 고대역폭 메모리(High Bandwidth Memory, 이하 "HBM")⁵ 칩을 통제하기 위해 메모리 대역폭 밀도 2GB/s/mm² 초과 디램(DRAM) 반도체를 통제품목으로 새로 추가하여, 통제분류번호(이하 "ECCN") 3A090.c.을 부여했습니다.⁶

해당 HBM 품목 및 관련된 소프트웨어(3D001) 및 기술(3E001)은 지역안정(RS)을 이유로 중국을 포함한 24 개국의 국가그룹 D:5(무기금수국)⁷ 및 마카오로 (재)수출 또는 국내 이전(한 국가 내에서 최종 용도나 최종 사용자의 변경)시 통제됩니다.⁸ 다만, 해당 통제에 대한 국가 안보 및 외교 정책과 관련된 우려를 해소하기 위해, 미국 또는 미국 동맹국(국가그룹 A:5(한국 포함))에 본사를 둔 업체가 대역폭 밀도 3.3GB/s/mm² 미만의 HBM 을 국가그룹 D:5 및 마카오에서 패키징하기 위해 (재)수출 또는 국내 이전하고자 하는 경우 상무부에 보고의무 등 일정 조건을 만족하면 예외적으로 허가 대상에서 제외될 수 있습니다.⁹ 또한, HBM 이 상위제품에 패키징되었고, 상위제품이 지역안정(RS) 사유로 통제된 첨단 반도체 칩에 해당하지 않는 경우 반도체 제조 관련 임시일반허가(Temporary General License)를 신청할 수 있습니다.¹⁰

한편, 해당 HBM 품목(3A090.c.) 추가로 3A090. 품목에 적용되던 기존의 첨단 컴퓨팅 관련 FDPR¹¹ 및 최종용도 통제 규칙¹²의 적용 범위도 확대되었습니다.

-
- 5 HBM은 D램 여러 개를 수직으로 쌓아 올린 고성능 메모리로 인공지능 AI 가속기 작동과 AI 훈련에 필수입니다.
- 6 단, 로직칩 등과 함께 패키징된 후의 HBM(co-packaged IC)은 3A090.c 통제대상에 해당하지 않지만 총연산성능(total processing performance) 및 성능 밀도(performance density)에 따라 3A090.a 또는 3A090.b와 같은 다른 통제대상에 해당될 수 있습니다.
- 7 미 산업보안국(BIS) 국가그룹(Country Groups)의 D:5는 미국 국무부가 지정한 무기금수국으로 중국, 아프가니스탄, 벨라루스, 버마, 캄보디아, 중앙아프리카공화국, 콩고민주공화국, 쿠바, 에리트레아, 아이티, 이란, 이라크, 북한, 레바논, 리비아, 니카라과, 러시아, 소말리아, 남수단, 수단, 시리아, 베네수엘라, 짐바브웨 등이 포함됩니다. 무기금수국에 대한 상세한 내용은 <https://www.bis.gov/ear/title-15/subtitle-b/chapter-vii/subchapter-c/part-740/supplement-no-1-part-740-country-groups> 참고.
- 8 EAR §742.6(a)(6)(i)(B) 참조.
- 9 금번 신설된 HBM 허가예외 조항 EAR §740.25 참조.
- 10 EAR Supplement no. 1 to Part 736 (d)(2)(ii)(B) 참조.
- 11 외국인산 HBM 품목도 국가그룹 D:5나 마카오에 본사를 둔 업체를 위해 D:1, D:4 또는 D:5(단, A:5, A:6에 동시에 해당되는 국가는 제외) 국가를 목적지로 수출되는 경우 일정한 통제를 받을 수 있습니다(첨단 컴퓨팅 관련 FDPR, EAR § 734.9(h) 참조).
- 12 외국인산 HBM 품목도 국가그룹 D:5나 마카오에 본사를 둔 업체를 위해 수출하는 경우 첨단 컴퓨팅 관련 최종용도 규정이 적용됩니다(EAR §744.23(a)(3) 참조).

2. 반도체 제조장비 통제 범위 확대

상무부는 첨단 칩뿐만 아니라 비첨단 칩의 생산에도 사용될 수 있는 일부 검사 장비 및 계측 반도체 장비를 통제품목에 추가하기 위해 ECCN 번호를 신설 및 개정했습니다. 이에 따라 노광, 식각, 증착, 계측, 세정 장비 등 신규 반도체 장비 24 종과 관련 소프트웨어 3 종이 통제 대상으로 추가됐으며, 기존 통제 대상 반도체 장비의 범위도 확장되었습니다.¹³ 이처럼 일부 반도체 장비의 ECCN 이 개정됨에 따라, (i) 국가안보(NS) 및 지역안정(RS)의 사유로 중국을 포함한 국가그룹 D:5(무기금수국) 및 마카오로의 (재)수출 또는 국내 이전시 허가가 요구되는 반도체 장비 품목의 범위가 확대되었으며,¹⁴ (ii) 특정 반도체 제조장비에 적용되는 첨단 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨팅, 우려거래자(Entity List) 각주 1 및 4 표시자 등과 관련된 FDPR 조항의 적용대상 품목의 범위도 확대되었습니다.¹⁵

아울러, 상무부는 반도체 제조장비(Semiconductor Manufacturing Equipment FDPR)에 대한 FDPR 을 신설하였습니다(EAR §734.9(k)). 이번 규정은 특정 반도체 제조장비 수출품목¹⁶이 (i)미국산 기술 또는 소프트웨어(SW)¹⁷를 직접 사용하여 생산된 외국산 제품, 또는 (ii) 미국산 기술 또는 SW 를 직접 사용한 공장이나 주요 장비로부터 생산된 외국산 제품인 경우 뿐만 아니라, (iii) 미국산 기술이나 소프트웨어가 사용된 해외 공장이나 주요장비에서 생산된 제품(예컨대, IC 칩)¹⁸을 포함(contain)하는 경우까지 통제대상으로 확대된 점에 유의해야 합니다.¹⁹ 또한, 관련 최소허용기준 조항을 신설하여 통제대상인 미국산 집적회로(IC)에 포함되었거나(incorporated in) 이를 포함한(contains) 특정 외국산 반도체 제조장비도 미국산 제품으로 간주되어 통제대상이 되도록,²⁰ 미국산 집적회로(IC)에 대해 0% 수준의 최소허용기준(de minimis)을

¹³ 신설된 ECCN: 3B993, 3B994 및 관련 SW 3D992, 3D993, 3D994; 개정된 ECCN: 3B993.c.1, 3B993.d.1, 3B993.d.2, 3B993.f.1.b.2, 3B993.o.1.a, 3B993.o.1.b, 3B993.p.1, 3B993.p.3

¹⁴ NS: EAR §742.4(a)(4) 및 RS: EAR §742.6(a)(6) 참조.

¹⁵ EAR §734.9(e) 및 §734.9(h)-(i) 참조.

¹⁶ 반도체 제조장비 3B001(a.4, c, d, f.1, f.5, k ~ n, p.2, p.4, r) 또는 3B002.c. (해당 품목을 위해 전용설계된 부품, 부분품, 약세사리 등도 포함될 수 있음)

¹⁷ ECCN 3D001(3B 품목 관련), 3D901, 3D991(3B991, 3B992 품목 관련), 3D992, 3D993, 3D994, 3E001(3B 품목 관련), 3E901(3B903 품목 관련), 3E991(3B991, 3B992 품목 관련), 3E992, 3E993, 3E994

¹⁸ 참고로 집적회로(IC) 생산에는 웨이퍼 상태의 집적회로 제작(fabrication of the integrated circuit in a wafer)뿐만 아니라 집적회로의 조립, 테스트 및 패키징도 포함됩니다(부가 설명은 Note 3 to EAR §734.9(k)(1)(ii)(B) 및 Supplement no. 3 to part 732 Red Flag 26 참조).

¹⁹ EAR §734.9(k)(1)(ii) 참조.

²⁰ 미 상무부 통제목록(Commerce Control List)의 Category 3(전자), 4(컴퓨터), 5(정보통신)에 명시된 미국산 집적회로(IC)에 포함되거나 이를 포함한 일정 반도체 제조장비 3B 품목(3B001.a.4, c, d, f.1, f.5, k ~ n, p.2, p.4, r 또는 3B002.c)의 목적지가 국가그룹 D:5 및 마카오인 경우 해당 미국산 집적회로(IC)에 적용되는 최소허용기준(de minimis)을 0%로 설정하였습니다.

적용하였습니다.²¹ 이처럼 일정 외국산 반도체 제조장비 관련 품목들은 국가그룹 D:5 및 마카오로 (재)수출 또는 국내 이전시 허가가 요구됩니다. 다만, 상무부는 관련 품목에 대해 동등한 수준의 통제를 적용한 국가²²에 소재하면서 국가그룹 D:5 및 마카오에 본사를 두지 않은 업체에게는 허가를 면제해 주었습니다.

3. 우려거래자 목록 관련 FDPR 조항 신설 및 등재자 추가

상무부는 '우려거래자(Entity List)²³ 각주 5 표시자' FDPR(EAR §734.9(e)(3))를 신설하였는데, 각주 5 표시자에게 (i) 특정 미국산 소프트웨어나 기술²⁴을 사용하여 생산된 외국산 반도체 장비²⁵, (ii) 미국산 기술 또는 SW 를 직접 사용한 공장이나 주요 장비로부터 생산된 외국산 제품뿐만 아니라 (iii) 미국산 기술이나 소프트웨어가 사용된 해외 공장이나 주요장비에서 생산된 제품(예컨대, IC 칩)²⁶을 포함(contain)하는 외국산 반도체 장비²⁷ 또는 (iv) 통제대상 미국산 IC에 포함되거나 이를 포함한 외국산 제품²⁸을 (재)수출 또는 국내 이전시 허가를 받아야 합니다.²⁹

더불어, 상무부는 중국의 군민 융합 전략을 지원하거나 중국 첨단노드 IC 개발 및 생산과 관련된 첨단 반도체 제조시설, 반도체 장비 제조기업, 투자회사 등 총 140 개 기업·기관을 우려거래자 목록에 추가 등재하였는데,³⁰ 신규 등재자 및 기존 등재자 중 총 16 개 법인이 '우려거래자 각주 5 표시자'로 지정되었습니다.³¹

그 외 상무부는 일부 우려거래자 리스트 등재자에 대해 비첨단 IC 생산을 위한 저사양 품목, 통제목록(CCL)에 포함되지 않은 품목 등을 (재)수출하거나 국가 내 이전할 경우

²¹ EAR §734.4(a)(8) 참조.

²² Supp no.4 to EAR Part 742 참조. 2024. 12. 5. 현재 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 영국 등 총 33개국

²³ 우려거래자 리스트 등재자들은 미국의 국가안보 및 대외정책에 위해가 되는 외국 개인 또는 단체로, 이들과 관련되어 미국 EAR 적용 품목 수출 시 미국 상무부의 허가를 받아야 합니다.

²⁴ ECCN 3D001(3B 관련 상품의 경우), 3D901, 3D991(3B991 및 3B992 관련 상품의 경우), 3D992, 3D993, 3D994, 3E001(3B 관련 상품의 경우), 3E901(3B903 관련 상품의 경우), 3E991(3B991 또는 3B992 관련 상품의 경우), 3E992, 3E993, 3E994

²⁵ 반도체 제조장비 ECCN 3B001(3B001.a.4, c, d, f.1, f.5, g, h, k~n, p.2, p.4, r 제외), 3B002(3B002.c 제외), 3B903, 3B991(3B991.b.2.a~b 제외), 3B992, 3B993, 3B994. (해당 품목을 위해 전용 설계된 부품, 부분품, 약세서리 등도 포함).

²⁶ 참고로 집적회로(IC) 생산에는 웨이퍼 상태의 집적회로 제작(fabrication of the integrated circuit in a wafer)뿐만 아니라 집적회로의 조립, 테스트 및 패키징도 포함됩니다. (부가 설명은 EAR §734.9(e)(3)(i)(B)(2) 및 Supplement no. 3 to part 732 Red Flag 26 참조)

²⁷ EAR §734.9(e)(3)(i) 참조.

²⁸ 최소허용기준(de minimis) 조항 EAR §734.4(a)(9)을 신설: CCL의 Category 3, 4, 5에 명시된 미국산 IC에 포함되거나 이를 포함한 ECCN 3B(3B001.a.4, c, d, f.1, f.5, g, h, k~n, p.2, p.4, r 및 3B002.c 제외) 반도체 장비의 목적지가 우려거래자 각주 5 표시자일 때 해당 미국산 집적회로(IC)에 적용되는 최소허용기준(de minimis)을 0%으로 설정하였습니다.

²⁹ 우려거래자 등재자 및 품목에 따른 허가요건은 EAR §744.11(a)(2)(v)조 참조.

³⁰ 한국 소재 중국계 기업 'ACM 리서치 코리아'와 '엠펜리언 코리아' 2곳 포함.

³¹ Entity List 확인 방법: <https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20744>

허가를 예외적으로 취득할 필요 없다는 허가예외 RFF(Restricted Fabrication Facility)를 신설하였습니다. 허가예외가 적용된 우려거래자 등재자는 등재자의 허가정책(License review policy)란에 “EAR §740.26”(RFF 허가예외 조항)를 참고하라는 표시가 되어 있습니다.

4. 기타 주요 개정 사항

상무부는 전자 컴퓨터 활용 설계(Electronic Computer-Aided Design, ECAD)나 기술 컴퓨터 지원 설계(Technology Computer Aided Design, TCAD) 소프트웨어 및 기술이 국가그룹 D:5 및 마카오에서 첨단노드 IC³² 설계에 사용되지 않도록 첨단노드 IC 제조 관련 최종용도 통제 규정(EAR §744.23(a)(2))을 강화하였습니다.³³

아울러, 상무부는 조항(EAR §734.19(b))을 신설하여, 사용자가 (i) 특정 소프트웨어나 하드웨어에 접근하거나, (ii) 기존 소프트웨어나 하드웨어의 사용 라이선스(use licenses)를 갱신하는 ‘소프트웨어 키(software key)’도 EAR 통제를 받는다고 규정하였습니다. 이때, 해당 소프트웨어 키의 통제분류번호(ECCN)는 관련 소프트웨어나 하드웨어의 ECCN 과 동일하며, 동일한 통제가 적용됩니다.

III. 시사점

금번 개정으로 국내 업체가 특정 반도체 관련 통제 품목을 미국이 지정한 무기금수국(중국 포함) 및 마카오, 또는 우려거래자에게 수출하려면 허가를 받아야 하는 범위가 확대된 점에 유의해야 합니다. 상무부는 FDPR 관련 조항과 연계된 최소허용기준 조항을 신설하고 확대 적용함으로써, 한국을 포함한 제 3 국에서 생산된 특정 반도체 장비라도 △미국산 기술 또는 소프트웨어를 직접 사용한 공장이나 주요 장비로부터 생산된 제품(IC 칩)을 포함한 외국산 제품이거나 △특정 미국산 IC 칩을 포함한 외국산 제품까지 EAR 통제대상으로 지정하고 있습니다. 한국에 적용되는 통제품목이 증가한 만큼, 이번 조치에 대한 의견이 있는 기업들은 한국 정부와 협의하여 관련 의견이 상무부에 전달되고 반영될 수 있도록 적극적으로 대응할 것을 고려해 볼 수 있습니다. 참고로, 금번 조치와 관련한 의견은 2025. 1. 31.까지 미 상무부에 제출할 수 있습니다.

³² 미 상무부는 금번 조치를 통해 추가된 HBM 및 기타 메모리 장치를 포괄하기 위해 첨단노드 IC(Advanced-node ICs) 정의를 수정하였습니다(수정한 내용은 굵은 글씨로 표시): 첨단노드 IC란 (가) 비평면 트랜지스터 구조 또는 16/14nm 이하 노드로 제조한 로직 IC; 또는 (나) 128단 이상의 NAND 메모리 IC; 또는 (다) DRAM 집적회로서 다음의 것 : (i) 메모리 셀 면적이 $0.0019\mu\text{m}^2$ (square micrometers) 미만인 것 또는 (ii) 메모리 밀도가 0.288기가비트/mm²(gigabits per square millimeter) 초과인 것.

³³ 단, ‘우려거래자(Entity List) 각주 5 표시자’ FDPR의 통제와 중복되지 않도록 하였습니다.

아울러, 미 상무부는 미국과 유사한 수출통제를 자체적으로 운영하는 일본과 네덜란드를 포함한 33 개국(현재 2024. 12. 17. 기준)³⁴에 대해 상무부의 허가 없이 수출할 수 있도록 예외를 적용하고 있지만,³⁵ 한국 기업의 경우 금번 추가된 반도체 장비 등 통제품목을 중국에 수출할 경우 상무부의 허가를 받아야 하며, 이에 따라 한국 기업들의 경쟁력이 약화될 가능성이 있습니다. 다만, 우리나라도 미국, EU 등 세계 주요국들의 강화된 국제수출통제에 공조하기 위해 유사한 수준의 수출통제를 운영할 수 있도록 관련 국내 법령들을 개정하고 있어, 이에 따른 행정적 부담은 장차 완화될 것으로 예상됩니다.³⁶ 따라서 관련 기업들은 「전략물자 수출입고시」 개정 동향을 면밀히 모니터링하며, 추가되는 전략물자 및 상황허가 품목을 확인하는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.³⁷

또한, 중국 정부의 반응과 대응조치 역시 주시할 필요가 있습니다. 중국 정부는 즉각 이번 반도체 제재를 '경제적 강압 행위'로 규정하며, 수출통제 남용에 맞서 중국 기업의 합법적 권익을 보호하기 위한 대응 조치를 취할 것이라고 밝혔고, 실제로 그 다음 날인 24. 12. 3. 중국 정부는 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 초경질 재료 등의 대미 수출금지 조치를 발표하였습니다.³⁸

이처럼 미중 간 첨단기술 경쟁이 심화됨에 따라 각국의 수출통제 조치도 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 월스트리트 저널(Wall Street Journal)은 2024. 12. 13. 바이든 행정부가 중국으로의 우회수출을 제한하기 위해 대규모 컴퓨팅 시설이 있는 국가에 출하되는 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 반도체의 선적량 상한선을 설정하는 새로운 규제를 도입하고, 이 규제가 주로 동남아 (싱가포르, 말레이시아) 및 중동 국가에 적용될 것으로 전망된다고 보도했습니다.³⁹ 따라서 관련 기업들은 수출통제 조치를

³⁴ 산업통상자원부는 금번 조치로 관련 통제 품목을 생산하는 한국 기업에도 다소 영향이 있을 수 있으나, 향후 미국 규정이 허용하는 수출방식으로 전환함으로써 영향을 최소화할 수 있을 것이라고 전망했습니다(산업부 보도자료 (2024.12.12.). "미(美), 고대역폭메모리(HBM)반도체장비 수출통제 조치 발표" 참고.).

³⁵ 허가예외 IEC(Implemented Export Control) 조항 EAR §740.24 참조.

³⁶ 최근 산업부는 2024. 12. 6. 「제36차 전략물자 수출입고시」 개정안을 행정 예고하면서, 미국, EU 등 세계 주요국들의 강화된 국제수출통제에 공조하기 위해 양자컴퓨터, 양자컴퓨터용 동위원소, 극저온 냉각시스템, 극저온 측정장비, 3D 프린트, 고온코팅 등 21개 전략물자를 추가 지정할 것이라고 발표하였습니다. 해당 품목들 상당수가 미 상무부가 지난 '24. 9. 발표한 대중 수출통제조치가 적용되는 첨단산업 관련 품목들과 겹치는 것으로 이해됩니다(산업부 보도자료 (2024.12.6.). "전략물자수출입고시 개정안 행정예고" 참고.).

³⁷ Supplement no. 4 to part 742

³⁸ 중국 상무부는 (1) 미국 방산기업 또는 미국에 대한 군사용 이중용도 품목 수출금지, (2) 갈륨·게르마늄·안티몬·초경질 재료 등 이중용도 품목 대미 수출 금지, (3) 대미 흑연 수출 시 최종사용자, 최종용도 심사 엄격 시행하는 등 내용을 골자로 한 수출금지 조치를 발표했습니다(AP통신(2024.12.3.). "China bans exports to US of gallium, germanium, antimony in response to chip sanctions". 참고

³⁹ WSJ (2024. 12. 13.). "U.S. Prepares New AI Chip Restrictions to Close China's Backdoor Access."

<https://www.wsj.com/tech/u-s-prepares-new-ai-chip-restrictions-to-close-chinas-backdoor-access-a598d0fc>

위반하는 상황이 발생하지 않도록⁴⁰ 사전에 적절한 리스크 평가와 내부 검토를 거치고 컴플라이언스 조치를 취하여야 할 것으로 생각됩니다. 특히, 각 정부에서 발표하는 추가 조치나 위험징후에 대한 가이드라인⁴¹을 면밀히 모니터링하여 주기적으로 시스템을 업데이트할 것을 권해드립니다.

법무법인(유한) 태평양은 통상 TF를 운영하며 다양한 업무 경험과 노하우를 축적하였으며, 탁월한 전문성과 풍부한 실무경험을 가지고 있습니다. 빠르게 변화하고 있는 국제통상이슈를 최전선에서 대응하고 있으며, 통상, 투자, 중재, 무역구제, 관세 등 분야별 전문가들이 고객이 필요로 하는 현실적이고 실무적인 해결책을 제공해 드리고자 노력하겠습니다.

40 (참고) 미국 수출통제개혁법(Export Control Reform Act)에 따르면, 고의 또는 악의적으로 EAR을 위반할 경우 (i) 최고 20년 실형 또는 1백만 달러 벌금을 형사처벌로 부과하고 있고, (ii) 그 밖의 경우 거래액의 2배(2024년 기준 최고 36만 달러)를 행정처벌로 부과하고 있습니다.

41 i.e., 수출자는 수출품이 수출허가 대상이 되는지 여부를 사전에 스스로 판단해야 할 책임이 있는데, 미 산업보안국(BIS)은 수출자가 반드시 의심을 가지고 검토해야 할 사항들을 “고객 확인 가이드스 및 우려 징후(Know Your Customer” Guidance and Red Flags)” 가이드스에 명시했습니다. 금번 개정을 통해 우려 징후 8종(Red Flag 20-27)이 추가되었는데 자세한 내용은 EAR Supplement no. 3 to part 732에서 참고 부탁드립니다.

관련 구성원

김지이나

변호사

T 02.3404.0698

E jeena.kim@bkl.co.kr

권소담

변호사

T 02.3404.7651

E sodam.kweon@bkl.co.kr

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인(유한) 태평양의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려드립니다. 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우 위 연락처로 문의주시기 바랍니다.